

2021年10月吉日

各位

株式会社 高木化学研究所
名古屋ネプコンジャパン出展係

ご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、弊社はこの度、下記の通り「第4回名古屋ネプコンジャパン」に出展いたします。ぜひとも貴殿に、弊社の高熱伝導性高分子複合材料をご覧いただきたく、ご案内申し上げます。尚、展示会場への入場には、来場者1名につき、1枚の招待券が必要です。追加でご入用の場合には弊社までご連絡ください。弊社社員・スタッフ一同、ご来場を心よりお待ちしております。

敬具

記

第4回 **名古屋 ネプコン ジャパン**
エレクトロニクス開発・実装展

会期：2021年10月27日[水]～29日[金]

会場：ポートメッセなごや 第3展示館

弊社ブースNO. **16 - 33**

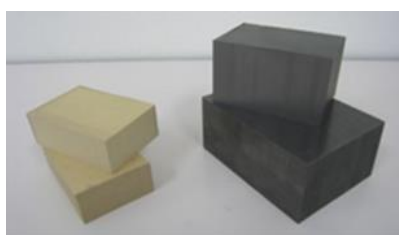
開場時間：10:00～17:00

最寄駅：あおなみ線『金城ふ頭駅』

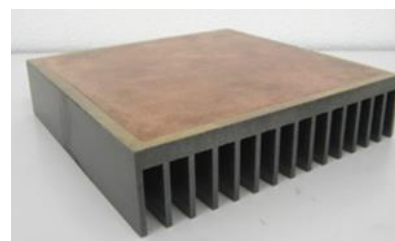
※金山駅、刈谷駅、豊田市駅から会場までのシャトルバス(有料)が運行予定されています

～ 出展製品のご紹介 ～

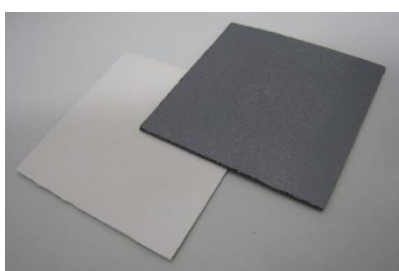
メカノケミカル合成技術を駆使した特殊なモルフォロジー制御によって、高い熱伝導率および優れた電気特性を有する扁平状高熱伝導性フィラー含有熱可塑性樹脂複合材料からなる粉末コンパウンドを開発し、圧縮成形や射出成形によって様々な用途への展開を図っています。その成果を展示しています。



熱伝導性複合材ブロック
(最大サイズ 150×150×40mm)



高熱伝導性複合材料の
銅張基板



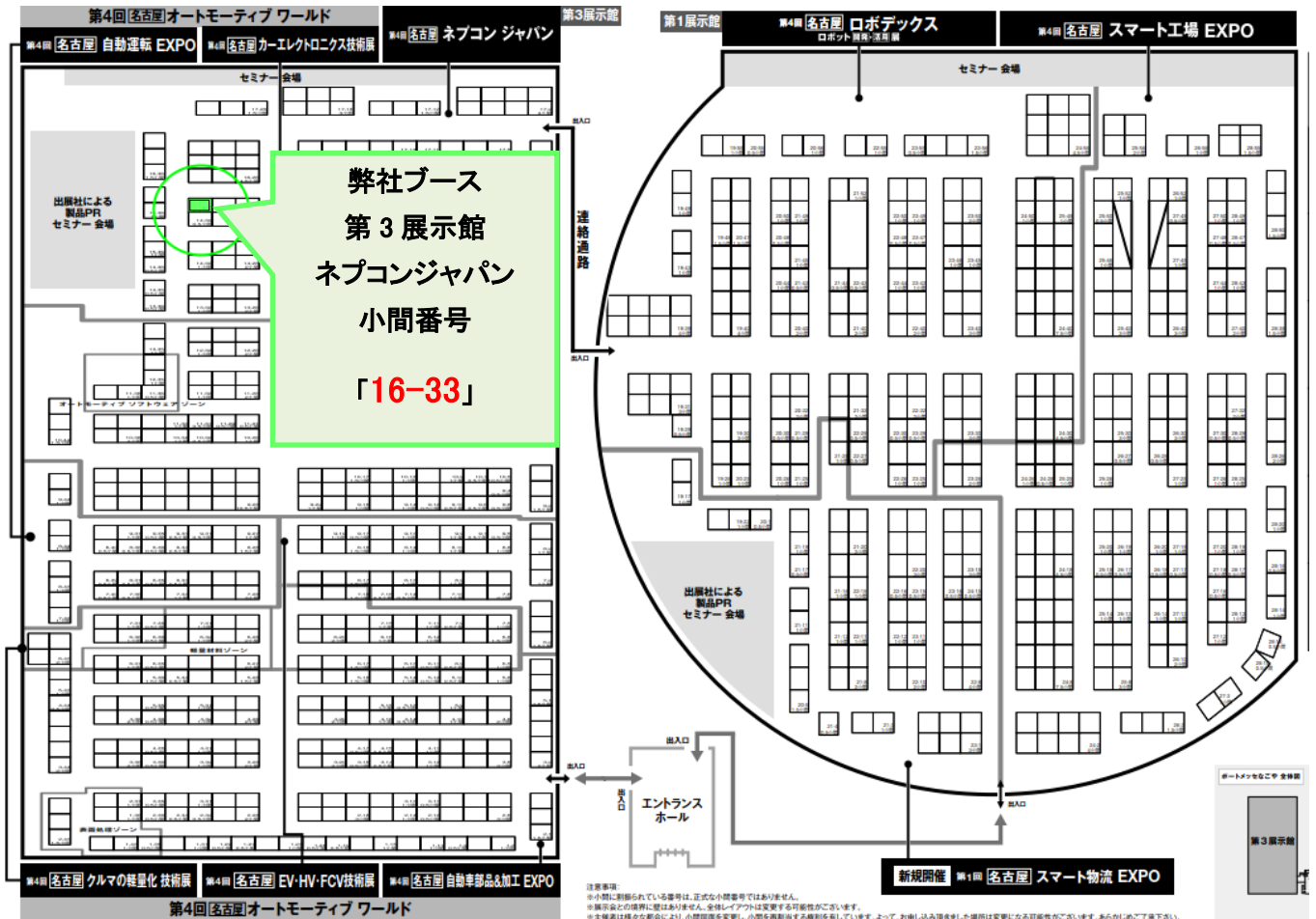
高熱伝導性シート成形品
(サイズ 250×500mm、厚み 0.3～0.5mm)



高熱伝導性モーター用
インシュレーター

以上

～ 弊社出展場所のお知らせ ～



～ 前回出展時（第6回 自動車部品&加工 EXPO）の様子 ～



ご不明点、招待券追加請求等は、下記担当までお問い合わせください。

担当：技術開発課 渡邊 大輔

TEL：0564-85-1966 FAX：0564-82-3605

E-mail：info@takagi-kagaku.co.jp

